

骨二半导体激光伤口愈合仪参数

激光波长：A 波：810nm B 波：650nm

终端输出功率：A 波：1200mw（810nm） B 波：100mw（650nm）

照射定时：1-30 分钟连续可调

控制部分：双 CPU

工作模式：连续/脉冲

设备输入电源要求：AC220V $\pm$ 22V50Hz $\pm$ 1Hz

设备输入功率：140w-200W